



H2158

环氧导电银胶

H2158 是一款单组份导电银胶，主要应用于摄像头模组，电子纸，电子标签等对热比较敏感的器件粘接。产品具有良好操作性可点胶可印刷。该产品不含溶剂并且无渗出，环保并且储存稳定。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	银色膏体
组分	单组分
固化方式	热固化
应用	导电粘接
典型的产品应用	摄像头模组，电子纸，电子标签

产品优点

- 良好的操作性
- 不含溶剂并且无渗出
- 优异的粘接性能
- 符合RoHS法规

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 pa. s	~12	GB/T 2794 Brookfield, 转速5 rpm
触变指数 TI	5.4	GB/T 2794
室温有效期	12 小时	@ 25°C

固化后性能

条目			典型值	备注
物理性能	热膨胀系数	Tg 以下	55	DMA, 升温速度10°C/min



	ppm/°C	T _g 以上	160	
	玻璃化转变温度 (T _g) °C		120	DMA
	粘接强度 kgf		12	2mm Si 芯片 / Ag 基板
	导热率 w/m.k		6	Laser Flash 法
	热失重%		0.6	/
电气性能	体积电阻率 Ω . cm		6*10 ⁻⁴	ASTM D257

典型的固化特性

推荐固化条件：1hrs@80℃；10mins@120℃；3mins@150℃。

固化条件（时间和温度）因固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而异，应依据客户经验、应用要求而调整。

使用方法

解冻：使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间 1.5h。解冻后擦干针筒表面冷凝水后方可使用。

使用：银胶解冻后需在 12h 内使用完，建议室温 25℃，湿度 60%RH 环境下使用。

固化：1hrs@80℃

标准包装

- 5ml 针管装
- 10ml 针管装
- 30ml 针管装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-40℃，湿度不高 60%，避光防晒，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一



特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司总部

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com